

鍍銅分層與剝落的解決方案



電鍍的關鍵在於金屬表面處理上需經過完全清潔，如果物體表面有部分被油或其他類型的干擾膜覆蓋，形成的隔離薄膜會中斷電鍍沉積反應，並產生孔隙凹坑、且降低粘附程度，進而導致電鍍後分層和鍍層剝落的問題發生，產生電鍍不良品。

尤其在鍍銅分層與剝落 (copper peeling) 的議題上，是由於多種因素造成，很難快速排除問題。造成的可能原因如下：

- 電鍍不完全
- 浸泡時間
- 氧化
- 預處理清潔不完全
- 沖洗不完全
- 清潔劑不適合
- 浸出效果差

Suntex的銅/鎳離子分析儀無須試劑的測量方法，提供全面的銅/鎳溶液監控。特別是在PCB蝕刻製程和電鍍工作要求迅速做出準確決策，我們的分析儀不僅提供即時的測量結果，分析儀本身配備蠕動泵一體化設計，實現自動採樣。

此外，搭配一系列的水質監測控制產品線，能幫助您避免錯誤的電鍍條件，例如金屬雜質清洗不完全、pH值錯誤、電鍍液體比重過低、緩沖劑濃度不正確等。

